



**SiC-MOSFET-Module von Toshiba ermöglichen die Verkleinerung industrieller Anwendungen bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz**

**Düsseldorf, 8. März 2021** – Toshiba Electronics Europe GmbH („Toshiba“) hat sein Know-how bei Halbleiterprozessen mit großer Bandlücke (WBG; Wide Bandgap) genutzt, um ein kompaktes, effektives MOSFET-Modul vorzustellen. Das neue MG800FXF2YMS3 enthält 2-Kanal-Siliziumkarbid-(SiC-)MOSFETs mit einer Nennspannung von 3300V, die Ströme bis 800A unterstützen. Zu den Hauptanwendungen dieser Module mit hoher Leistungsdichte zählen industrielle Antriebe und Motorsteuerungen, Wechselrichter im Bereich erneuerbarer Energien sowie Umrichter für die elektrische Bahninfrastruktur.

Entscheidend für die hervorragenden Leistungsparameter der neuen SiC-MOSFET-Module ist Toshibas eigene Gehäusetechnik. Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, werden in diesen Modulen iXPLV-Gehäuse (Intelligent Flexible Package Low Voltage) verwendet, die auf einem fortschrittlichen silbergesinterten internen Bonding basieren. Kanaltemperaturen bis zu 175°C werden unterstützt, während eine Isolation bis 6000V<sub>eff</sub> sichergestellt ist. Die Ein- und Ausschaltverluste werden auf 250 bzw. 240mJ gehalten, wobei Streuinduktivitätswerte von nur 12nH zu erwarten sind.

Weitere Informationen unter:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.MG800FXF2YMS3.html>

###

**Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Neben HDDs umfasst das Produktsortiment des Unternehmens Leistungshalbleiter und diskrete Komponenten wie Dioden bis hin zu Logik-ICs optische Halbleiter sowie, Mikrocontroller und anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs) u. a.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Marketing, Vertrieb und Logistik-Services bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com).

**Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

E-mail: [solution-marketing@toshiba-components.com](mailto:solution-marketing@toshiba-components.com)

**Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

**Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: [www.publitek.com](http://www.publitek.com)

E-mail: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

**März 2021**

**Ref. 7326\_A\_GER**